股票代號 **7828**

INNOS
創新服務股份有限公司

創新服務(股)公司

上櫃前業績發表會

2026/3/25

主辦承銷商

凱基證券
KGI SECURITIES

免責聲明

- 本公司基於簡報當時之主客觀因素，對過去、現在及未來之營運進行彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論等所影響，容有超出本公司得以控制之部分，致實際情況或結果可能與上揭前瞻性論述大相逕庭。
- 本簡報所提供之資訊（包含但不限於對未來之看法），並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性，亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
- 本簡報中對未來之展望，僅反應本公司截至發表時點之看法；嗣後若有任何變更或調整，本公司不負提 醒及更新之責任。
- 本簡報及其內容非經本公司事前書面同意，任何第三人不得逕行援用或擷取之。

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

風險事項

- 產業風險
  1. 景氣循環波動之風險
- 營運風險
  1. 銷貨集中於探針卡設備之客戶群
  2. 具成熟技術的專業人才養成不易
  3. 財務風險
- 其他重要風險
  - **請參閱風險事項及補充揭露事項說明書第1~7頁。**

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

補充揭露事項

依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年1月23日證櫃審字第1150100166號函要求於風險事項乙節之補充揭露事項：

貴公司114年前三季來自關係人Technoprobe S.p.A.集團(下稱TP集團)合計之營業收入及營業利益比重分別為48.31%及61.05%，有銷貨集中情形，有關貴公司銷貨集中於TP集團之原因、雙方合作模式、面臨之風險及所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商及簽證會計師之評估意見。

貴公司近年營收以半導體客製化設備銷售為主，有關貴公司因應半導體景氣循環及客製化設備營收波動風險所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。

請參閱風險事項及補充揭露事項說明書第8~16頁。

依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年1月23日證櫃審字第1150100166號函要求於風險事項乙節之補充揭露事項：

有關貴公司業績變化合理性及未來發展性之說明，暨推薦證券商之評估意見。

貴公司主要產品或技術包含MEMS探針卡整線設備、銅柱巨量轉移技術，及銅柱通孔玻璃基板技術，分屬不同技術領域，有關貴公司開發各主要產品所需技術及研發能力、各產品應用布局策略，及相較市場現有技術差異或優勢之說明，暨推薦證券商之評估意見。

請參閱風險事項及補充揭露事項說明書第17~39頁。

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

INNOS®
創新服務股份有限公司

股票代號 7828

目錄

1. 公司簡介及經營理念
2. 產業及營運概況
3. 經營實績及未來展望
4. ESG永續推動

INNOS®
創新服務股份有限公司

股票代號 7828

1.公司簡介及經營理念

創新服務為您的製程創新、產品創新，

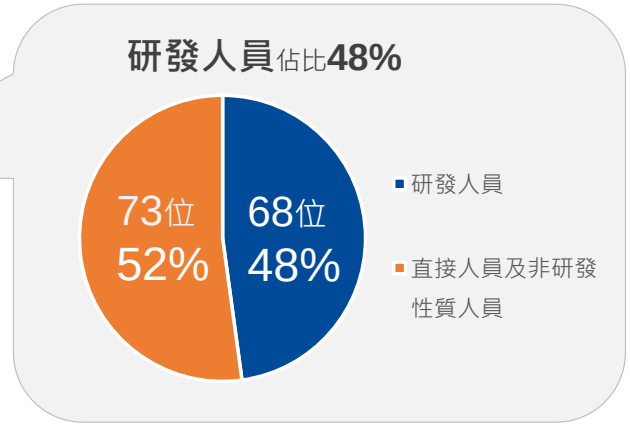
提供最專業整體解決方案。

公司簡介

股票代號 **7828**

INNOS® 創新服務股份有限公司
InnoStar Service, Inc.

- **創新服務成立於 2004 年**
- **資本額：新台幣3.67億元**
- **員工數： 141人**
- **服務據點**
  - 新竹廠
  - 台中總廠
  - 高雄辦公室
- **營業項目**
  - 半導體自動化設備開發、製造及銷售業務。
  - 先進封裝解決方案。
  - 先進封裝製程元件、製造及銷售業務。
  - 探針卡維修與材料服務與銷售業務。





© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

公司里程碑

股票代號 **7828**

2004

- 公司成立
- 推出第一代塑膠剪切機。
- **開啟光學產業自動化革命**

2014

- 切入半導體先進測試製程，開發半導體晶圓級測試MEMS探針卡自動植針設備
- **開啟探針卡植針自動化革命**

2016

- 取得半導體晶圓國際大廠MEMS探針植針代工業務，已累積超過3億根針經驗。

2022

- 自動化植針設備獲得主要探針卡大廠採用

2024

- 高密度銅柱端子模組，應用於WIFI模組大量送樣。
- 探針卡廠大量採用植針設備。



2025

- 高密度銅柱端子模組，應用於Power Module, TGV, PLP模組。
- TP成為策略投資人
- 推出MEMS探針卡Probe Card整體自動化維修解決方案



2026

- **高密度銅柱端子模組各項產品進行驗證與準備量產。**
- **MEMS探針卡Probe Card系列設備機台開發完成。**
- **Probe Card維修產能建置完成與投入**

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

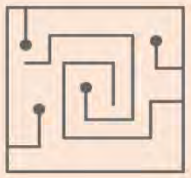


2. 產業及營運概況

產業概況

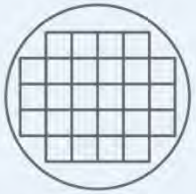
股票代號 **7828**

上游



IC設計
代工服務

中游



IC/晶圓製造

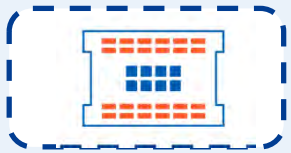
生產製程及檢測設備

光罩

化學品



IC檢測
(Chip Probing)



探針卡晶圓測試

下游



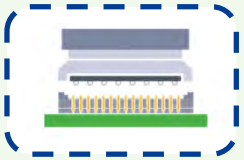
IC 封裝
Package

IC 測試

生產製程及檢測設備

基板

導線架



FT終端測試

IC通路



探針卡植針
及相關自動化設備



CoWoS基板
元件返修設備





高密度
銅柱端子



Pogo Pin植針
及相關自動化設備

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

產 品

探針卡
整線設備自動化方案

- 探針卡雷射鑽孔機
- 鑽孔檢查&陶瓷卡自動貼合
- MEMS探針卡雙臂植針機
- 探針卡IPQC檢查機
- 探針雷射塑形機、雷射探針卡清潔機
- 探針卡自動換針機
- 探針分選及整列機
- 探針卡分析測試機
- CoWoS FT自動化植針(90um)、檢測機



MEMS探針卡維修線

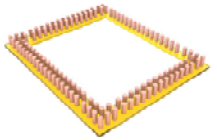
半導體
精密加工

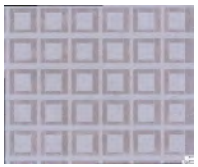
- 精密雷射切割設備
- Mini LED自動化檢測與雷射返修設備
- 精密雷射除膠機
- MEMS Mirror自動化精密組裝設備
- CoWoS基板元件返修設備
- 精密碰焊機

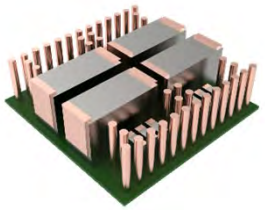


先進封裝

- WIFI Module高密度銅柱端子
- Power Module高密度銅柱端子
- Interposer (10:1)銅柱TGV







© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

MEMS探針卡整線設備自動化方案

股票代號 **7828**

INNOS探針卡生產與維修關鍵整線設備

探針卡 雷射鑽孔機 LS-11	鑽孔檢查 &陶瓷卡自動貼合 PHIA-01	MEMS探針卡 雙臂植針機 AT-105	探針卡 IPQC檢查機 PCR-01	探針雷射塑形機、雷射清潔機PHC-02	探針卡 自動換針機 PIR-02	探針分選 及整列機 PSA-01
開發完成	預計2026 Q1完成	開發完成	開發完成	開發完成	開發完成	開發完成



雷射鑽孔機 → 人工&
半自動貼合 → 人工插針 → 顯微鏡
下人工檢 → 半自動雷射清潔 → 人工作業
換針及量測 → 人工篩選

傳統 探針卡生產方式

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

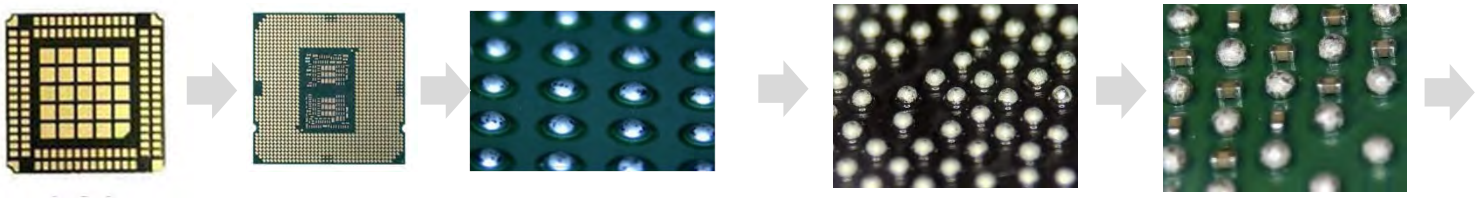
MEMS探針卡自動化設備/返修/材料包銷售 Timeline

股票代號 7828

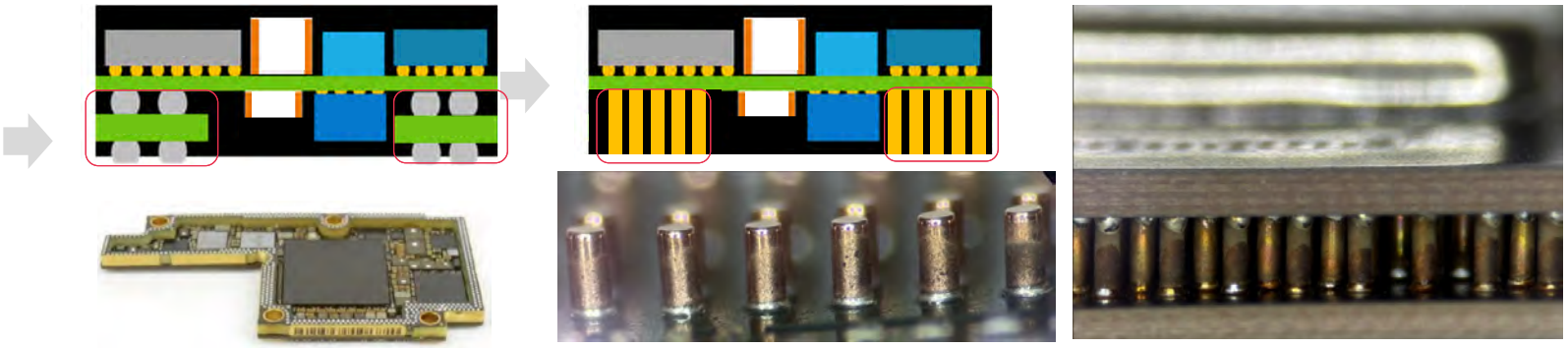
#	MEMS探針卡相關業務 產品名稱	2016- 2021	2022 2023	2024	2025				2026			
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	單Arm植針機	植針代工	銷售	大量銷售								
2	雙Arm植針機				開發	開發	開發	量產出貨				
3	探針卡IPQC檢查機					開發	開發	量產出貨				
4	探針雷射塑型機&探針卡清潔機					開發	開發	量產出貨				
5	探針卡自動換針機					開發	開發	量產出貨				
6	探針分選及整列機						開發	開發	量產出貨			
7	探針卡雷射鑽孔機				開發	開發	開發	開發	量產出貨			
8	鑽孔檢查&陶瓷卡自動貼合機					開發	開發	開發	量產出貨			
9	探針卡分析測試機							開發	開發	量產出貨		
10	探針卡Repair代工								產線建置	產線建置	代工生產	
11	探針卡材料包銷售					簽約/推廣	導入 客戶設計	少量出貨	銷售			

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

先進封裝 – Pin-Out導通技術演進



LGA | LSC (Land side capacitor) | Pre-solder | BGA | BSC (Ball side capacitor)



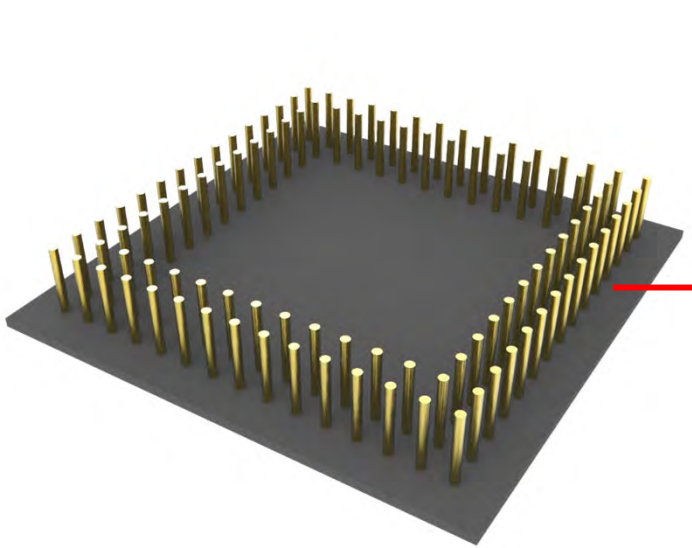
Frame Board

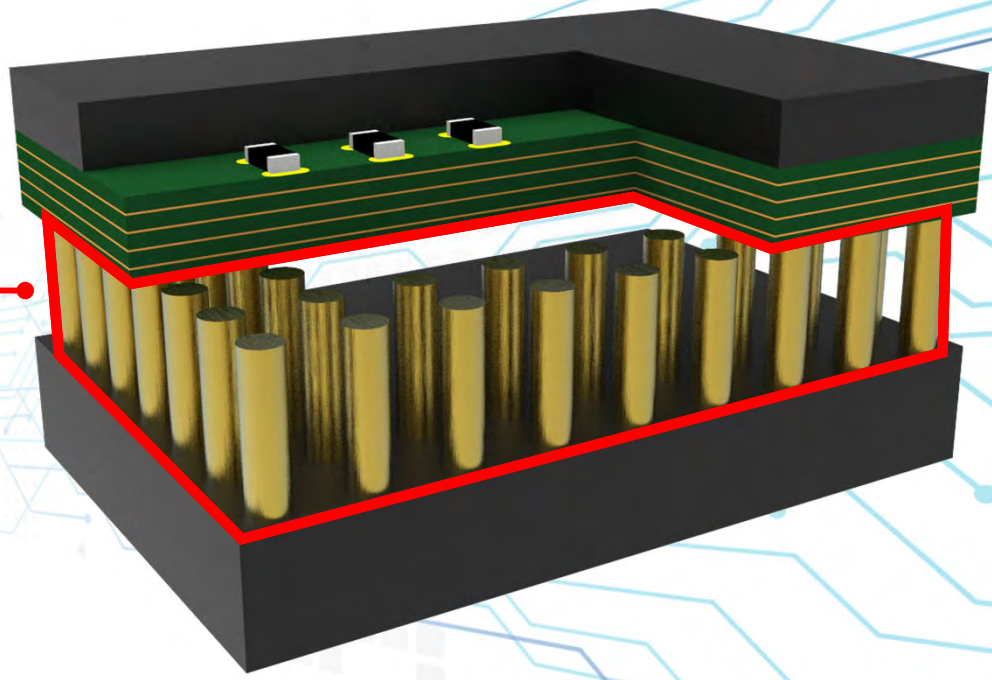
Cu-Pillar

- Fine Pitch
- Higher I/O
- Flexible Design Architecture
- Electrical
- Thermal
- Mechanical

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

高密度銅柱端子模組

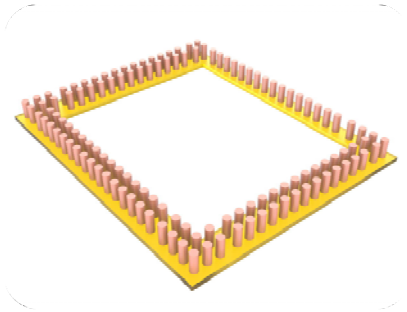




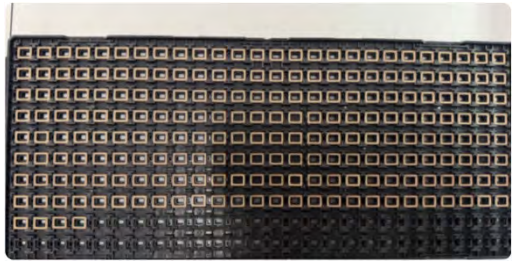
© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

客製化高密度端子銅柱模組

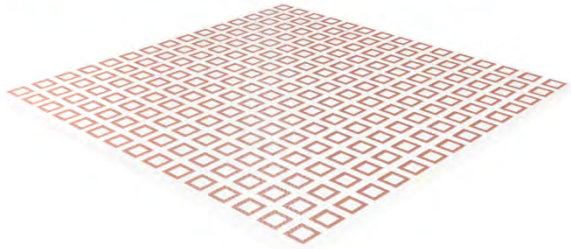
成品 示意圖



Tray



TGV

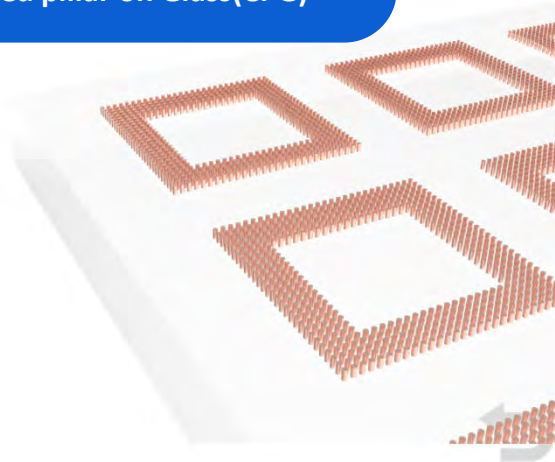


Tape &Reel





Cu pillar on Glass(CPG)

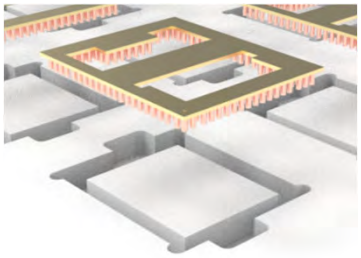
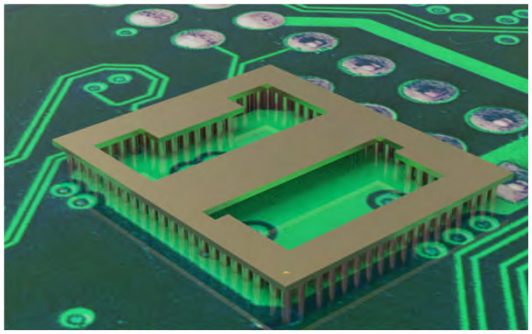
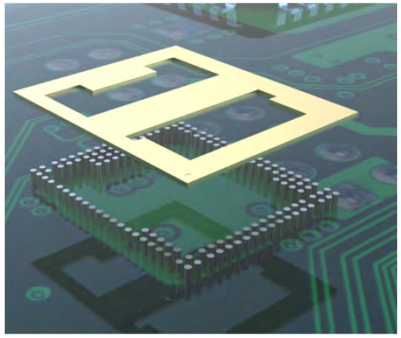
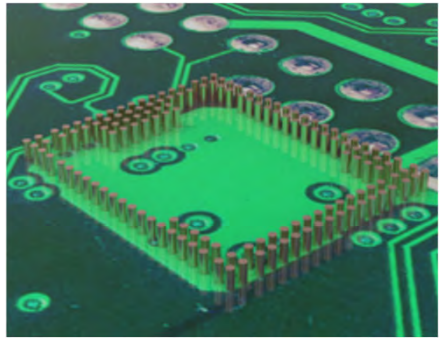


© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

銅柱Lead Frame模組 移轉流程

可水解 模組

Pick &Place → 吸嘴取放至PCB上 → Reflow → 85度熱水解膠 → 基板debonding → Molding Compound / Submolding or underfill




非水解 模組

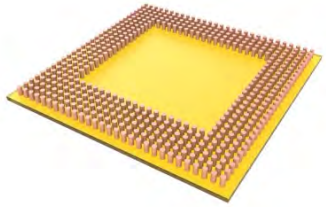
Pick &Place → 吸嘴取放至PCB上 → Reflow → Molding Compound → Grinding




© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

先進封裝高密度銅柱端子

成品 示意圖





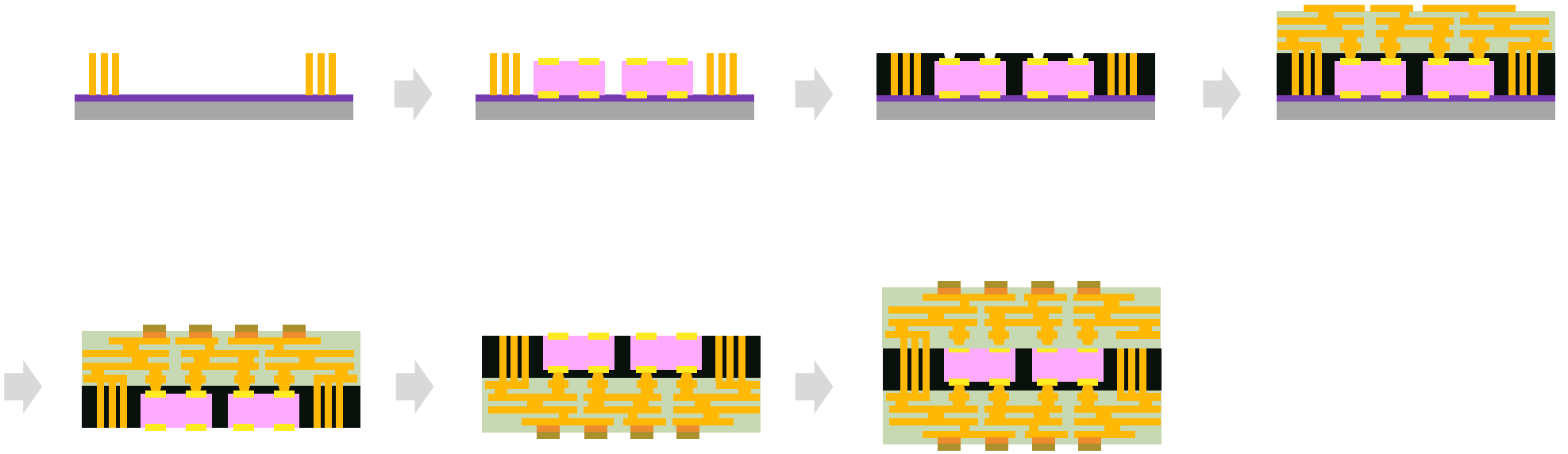


30,000pin/片

高密度銅柱端子適用於先進封裝有機載板、玻璃基板以及晶圓級先進封裝製程，應用於高深寬比、高導電、高散熱、異質整合封裝、功率模組封裝等銅柱導通連結應用。

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

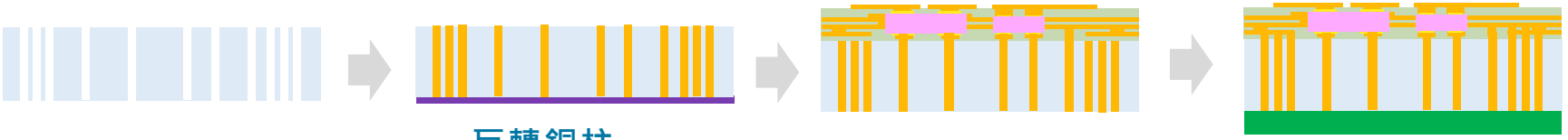
Cu pillar on Glass for PLP



© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

TGV Interposer 10:1 -RDL補強

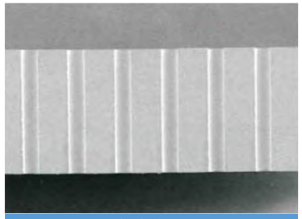
已通過Thermal Shock
-40 °C ↔ +125 °C (850 Cycles)



巨轉銅柱



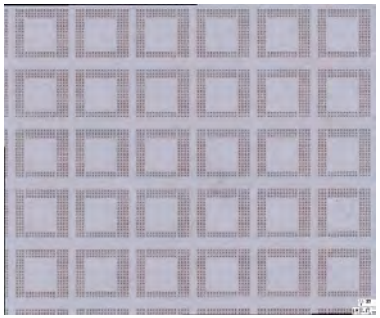
電鍍銅柱 <3:1

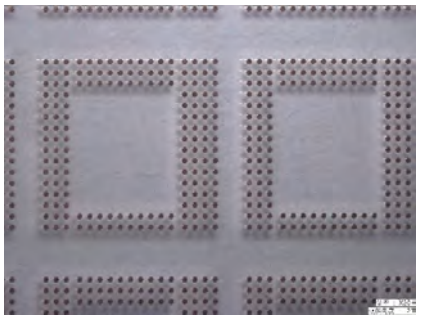


垂直通孔



smooth side wall



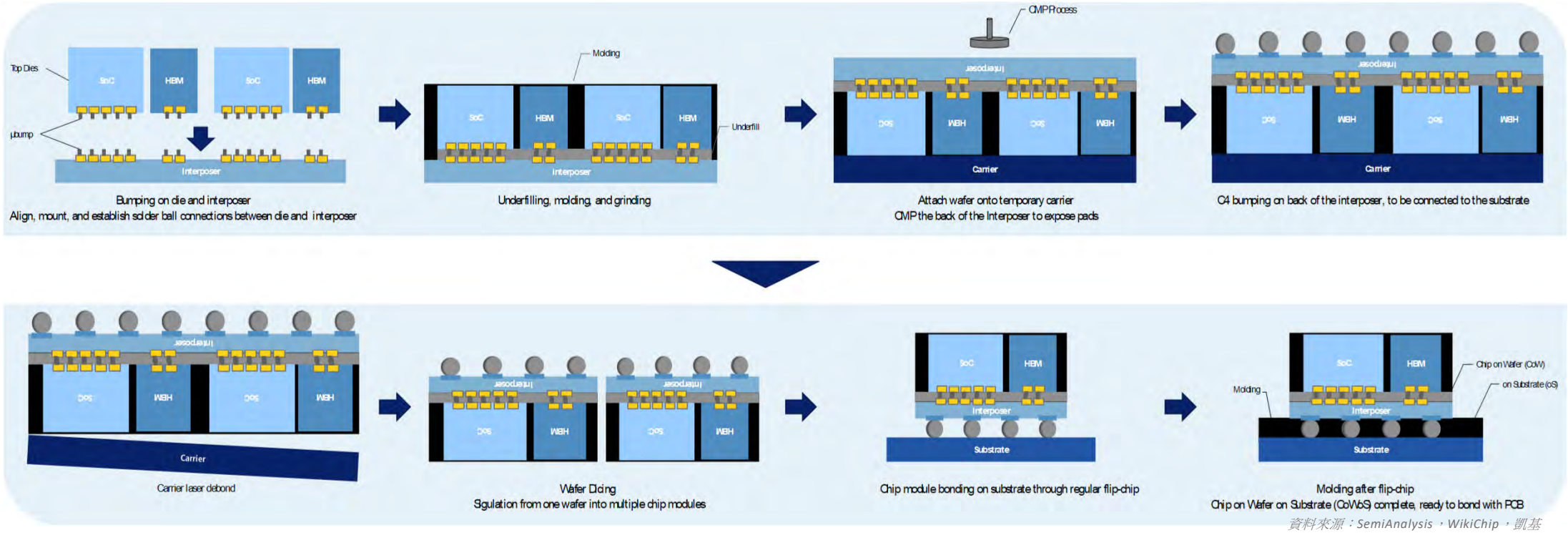




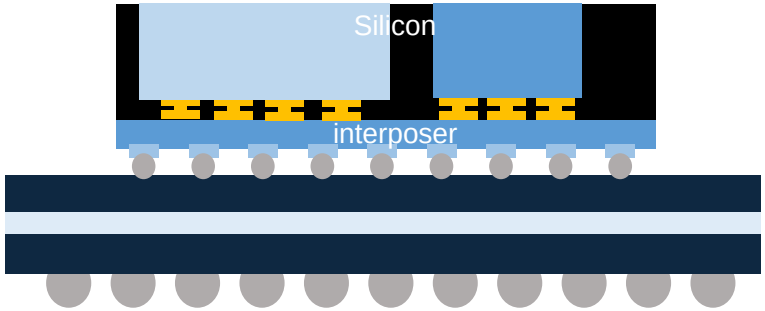
巨轉銅柱 10:1

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

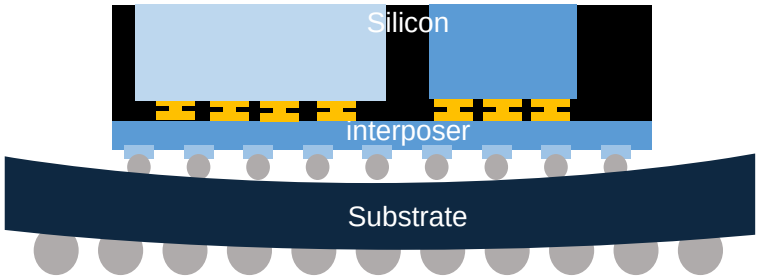
TGV



資料來源：SemiAnalysis，WikiChip，凱基



TGV

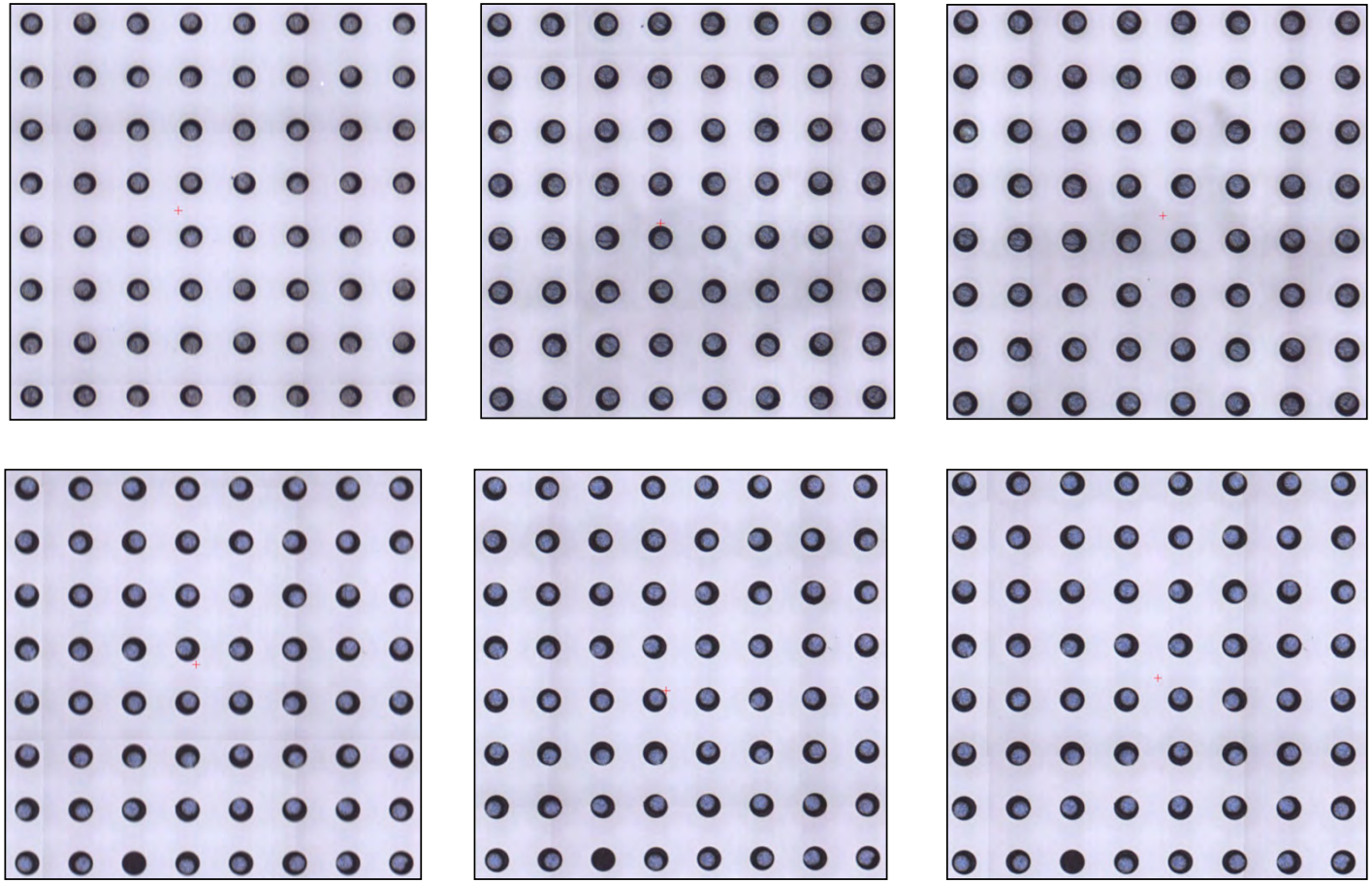


© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

Thermal Shock

-40 ℃ ↔ +125 ℃ (850 Cycles)

- **測試目的**
  - 驗證TGV在極端溫度反覆變化下的可靠度，評估熱膨脹差異造成的疲勞、裂紋與失效風險。
- **測試條件**
  - 標準：JEDEC JESD22-A104F
  - 溫度範圍：
    - 低溫：-40 ℃
    - 高溫：+125 ℃
  - 循環次數：850 Cycles
  - 典型轉換時間：≤10 min
  - 高低溫停留時間：約10–15 min
- **測試結果：PASS**



300次　620次　850次

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

高密度銅柱端子模組產品導入進度

股票代號 **7828**

客戶群	客戶數量	專案數量	導入階段
TGV 高速傳輸模組 	3	3	• NTI → NPI → **2027之後量產**
AI Power Module 	8	11	• NTI → EVT/DVT → PVT → **預計 2027 量產導入**
RF / 網通等 	5	10	• EVT/DVT → PVT → **2026 起逐步量產**
VR/AR 	1	2	• NTI / NPI 階段，量產規劃中

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

台中新廠-第一期工程

- 第1期工程，預計2026年Q1完成。
- 銅柱模組產線
  - 預計可擴充至**4條**產線
  - 產能：**10,000K** pcs/年
- TGV-ICP生產線
  - 預計可擴充至**12條**產線
  - 產能：**120K** 片/年

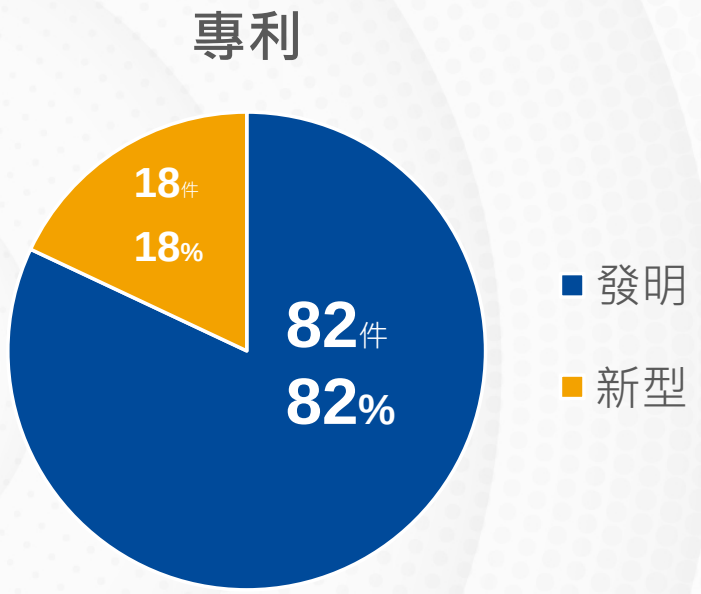


2025年8月7日購入
土地：台中市大甲區光明段686、687、687-1號
建築：台中市大甲區興安路130-1號
土地面積：3,558.00平方公尺（約1,076.2950坪）
建築面積：3,945.35平方公尺（約1,193.47坪）
預計第一期廠務完工日期：2026年第一季、第二期竣工日期：2027年第二季

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

專利成果

專利項目	已取得		審查中	
	發明	新型	發明	新型
半導體 先進製程設備	15	1	4	0
先進封裝設備 及相關產品	11	6	26	2
其他	14	8	12	1
小計	40	15	42	3



截至目前為止，本公司已取得55件專利(發明40件、新型15件)，另有45件專利申請中(發明42件、新型3件)。

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

INNOS®
創新服務股份有限公司

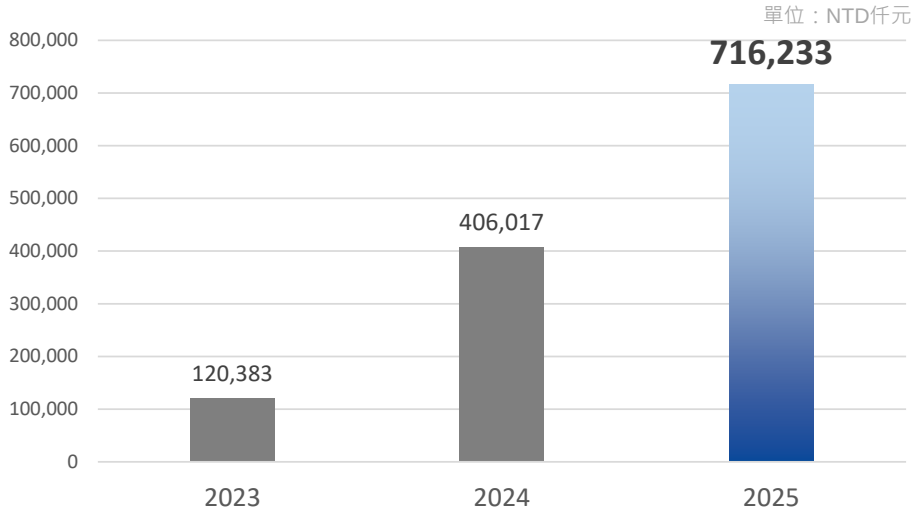
股票代號 7828

3. 經營實績及未來展望

經營實績

股票代號 **7828**

營收表現



財務成果

單位：NTD 仟元; 元

	2023	2024	2025
稅後淨利	(49,934)	149,887	**227,671**
毛利率	61.81%	80.26%	**76.25%**
EPS	(2.33)	5.25	**6.33**

- 2024年度營收較2023年度營收成長237.27%，2025年度營收較2024年度營收成長76.25%，主係半導體先進製程技術演進、受惠AI應用之終端客戶需求強勁，本公司成功開發出MEMS探針卡雙臂植針機及整線設備自動化解決方案，使MEMS探針卡相關設備持續穩健出貨， 維持成長上升趨勢。

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

未來展望-營運成長「三引擎」

股票代號 **7828**

半導體設備

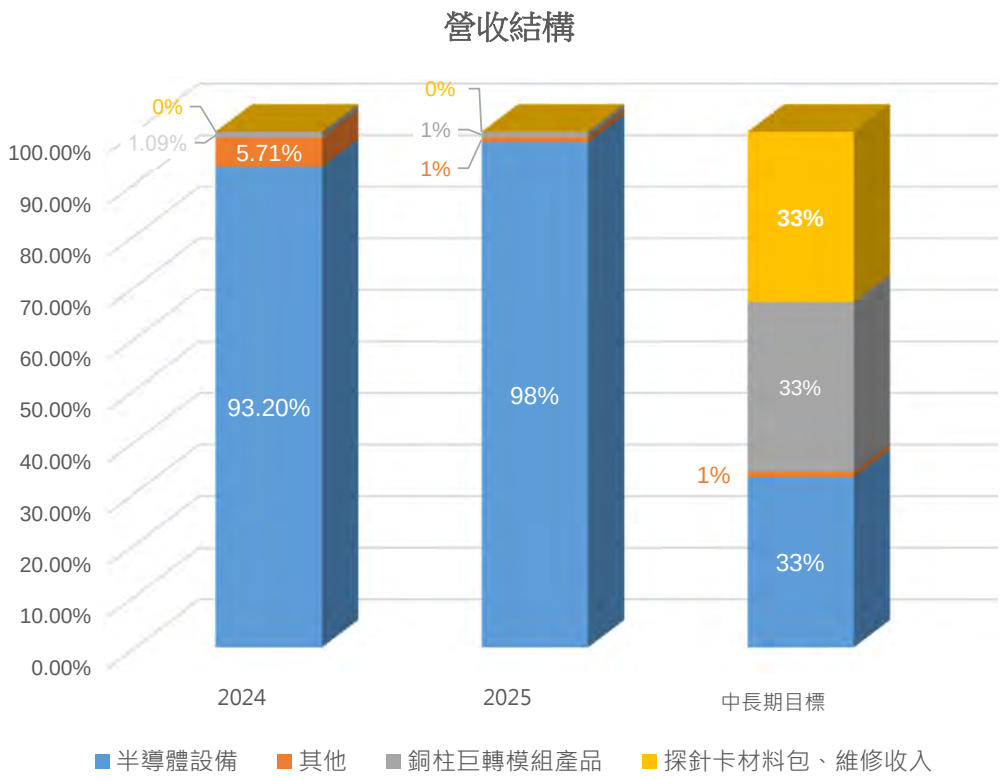
- 持續發展自動化設備，滿足客戶高成長的市場需求。
- 從單ARM植針機->雙ARM植針機。
- 開發探針卡維修自動化相關設備,縮短維修時程,提升競爭力。

探針卡材料包及維修

- 進階成為探針卡材料包供應商。
- 提供探針維修代工,縮短傳統探針卡維修週期。
- 增加探針卡材料包及探針卡維修之經常性收入。

銅柱巨轉模組

- 創新銅柱方案，專注Power 模 組 及 TGV CoWoS 封裝等市場。
- 2026可逐步量產應用於RF/網通、TGV高速傳輸模組；
- 2027可逐步量產應用於AI Power Module。



© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

INNOS®
創新服務股份有限公司

股票代號 7828



4. ESG永續推動

ESG永續推動

股票代號 **7828**

成立永續發展委員會，負責執行及推動公司永續發展之治理。預計於遷新廠後執行碳盤查，2026年中編製完成首本ESG報告書。



環境保護

- 分區空調與通風管理
- 垃圾分類與資源回收
- 節能照明管理
- 雨水回收與再利用系統
- 新廠導入太陽能源



社會責任

- 薪酬與績效連結
- 提供員工團保及員工健檢
- 定期辦理安全衛生教育訓練課程、特約護理人員臨場服務、工作作業環境監測
- 提供當地人員就業機會，優先晉用鄰近地區人員



公司治理

- 董事會運作與獨立性
  - 獨立董事席次已逾三分之一
  - 董事會性別多元
  - 股東權重適中、董事進修完備
- 誠信與資訊揭露
  - 落實誠信經營
  - 將各項財務業務等資訊揭露於公司網站

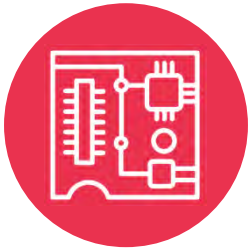
© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

本公司產品對客戶之永續與減碳效益



探針卡整線設備自動化方案

- 降低資源浪費：高精度植針與穩定製程控制，減少針材報廢與重工。
- 提升能源效率：縮短製程時間，降低單位產出所需能源。
- 導入自動化，有效改善人因工程：自動化取代高重複性與高負荷人工作業，降低人員健康風險。



TGV及銅柱模組取代傳統電鍍製程

- 減少電鍍製程所需之大量用電、用水、縮短製程流程。
- 降低電鍍重金屬污染、化學藥劑與廢液處理需求。

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

股票代號 **7828**

THANK YOU For Your Attention

創新服務股份有限公司 www.inno-stars.com